**國立清華大學半導體研究學院產學合作計畫書**

|  |  |
| --- | --- |
| 壹、基本資料：  |  |
| 計畫名稱(中英文) |  |
| 關鍵字 |  |
| 計畫主持人 | 姓名 |  | 計畫聯絡人(助理) | 姓名 |  | 電話 |  |
| 職稱 |  | E-mail |  |
| 服務單位 |  | 主持人E-mail |  |
| 主持人分機 |  | 主持人手機 |  |
| 執行期限 | 自民國 114 年 月 日起至民國 年 月 日 |
| 計畫類別 | □專題研究 □技術服務 其他： |
| 合作單位(企業) | 單位名稱 | (全銜) 力晶積成電子製造股份有限公司 |
| 計畫聯絡人 | 姓名 | 葛永年 資深處長陳俊丞 資深部經理 | 電話 | 03-5795000, Ext:5870 |
|  | E-mail |  len@powerchip.com jimchen@powerchip.com |
| 計畫總經費 | 新台幣 (待雙方討論與確認) 元 |
| 撥款方式 | (待雙方討論與確認)本計畫分 期撥款 第一期金額 　　　　　　　元第二期金額 　　　　　　　元其他 元 |

貳、產學合作計畫內容：

1. 主要目的詳述與預料成果 / Main idea of proposal and expected results
2. 創意、優勢、獨特性 / Innovation, benefit, and uniqueness against competitors
3. 挑戰及解決方案 / Challenges and means to overcome
4. 時程及人力初估 / Tentative time table and human resource
5. 提案者簡歷 / PI Personal Profile